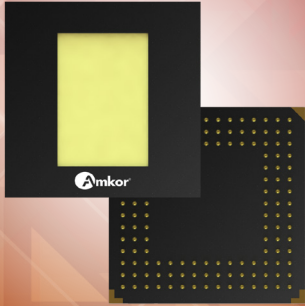


Optical Sensors

기술의 진보로 인해 높은 속도와 신뢰성을 자랑하는 센싱 애플리케이션에 대한 수요가 증가하게 되었고, 이로 인해 Optical sensor 개발은 더욱 활발해질 것입니다.

Optical Sensor는 다양한 파장을 전기적 신호를 변환해 정교한 센싱 애플리케이션에 사용되도록 합니다. 주변광, 적외선, 자외선 등이 자율주행 자동차, 디스플레이 내장 지문인식 스캐너, 정확한 안면인식 등을 위한 다양한 애플리케이션 제조를 위해 Optical Sensor가 측정하는 파장입니다. 다양한 센서와 광원의 융합은 신뢰성과 응집력이 개선된 센싱 시스템 제조에 매우 결정적인 역할을 합니다. 주변 환경 인식에 있어 기술에 더욱 의지하게 되면서 수많은 Optical Sensor를 도입하는 경우가 증가하고 있습니다.



OPTICAL SENSOR PACKAGING CONSIDERATIONS

앰코테크놀로지는 세계 Optical Sensor 패키징 기술 분야를 선도해왔으며 세계 최대 센서 패키지 외주 공급업체입니다.

GENERAL REQUIREMENTS

- ▶ 청정도 관리
- ▶ 센서의기울기/떨림 관리
- ▶ 광학용 소재

CONSUMER MARKET

- ▶ 패키지 통합
- ▶ 비용 효율이 높은 솔루션
- ▶ 소형화 로드맵

AUTOMOTIVE MARKET

- ▶ 더 철저한 디바이스 패키지 보호 기능
- ▶ IATF 16949 인증 획득
- ▶ AEC-Q100 인증 획득

Optical Sensor Applications

앰코테크놀로지는 자사 표준 패키지로 다양한 애플리케이션을 지원하는 패키지 기술 전문업체입니다.

MEMS/Sensor	Consumer Devices	Automotive	Health & Fitness	Home/Industrial
지문	✓	✓		✓
LIDAR		✓		✓
CIS	✓	✓		✓
주변광	✓	✓	✓	✓
3D 심도 감지	✓	✓		✓
ToF/AR/VR	✓	✓		✓
적외선	✓	✓	✓	✓
자외선	✓	✓		✓
분광기	✓		✓	
가스		✓		✓
열전대열				✓

Amkor's Value Proposition

- ▶ Optical sensor 제조
 - ▷ 표준화된 플랫폼 = 개발 기간 단축
 - ▷ 신제품의 신속한 도입 가능
- ▶ 개발 비용 절감
- ▶ 앰코의 경험
 - ▷ Optical Sensor 전담팀
 - ▷ 새로운 장비 및 재료 투자와 R&D 개발을 통한 지속적인 Optical Sensor 툴박스 업데이트
 - ▷ 자체 테스트 개발 능력



Optical Sensor

패키지 및 보드 레벨의 신뢰성

전 세계 주요 앰코의 생산법인에서 모든 신뢰성 테스트 서비스를 제공합니다.

모델링과 시뮬레이션

솔더 접합과 와이어 접합의 전기적, 열 기계적 신뢰성, 패키지 내 온도 분포, 케이스 내부 공기 흐름, S-parameter, 파형 측정

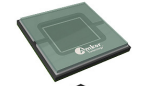
센서 관련 제조 활동을 하고 있는 앰코의 공장은 다음과 같습니다.

- ▶ 중국(ATC)
- ▶ 한국(ATK)
- ▶ 일본(J-Devices)
- ▶ 필리핀(ATP)

Optical Assembly Toolbox

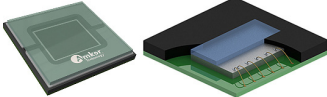
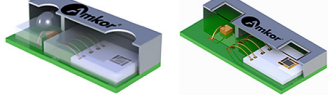
- ▶ 먼지 관리
- ▶ 정확한 초점 허용도
- ▶ 칩 노출과 캐비티 경험
- ▶ 투명 접착제
- ▶ CoB/CoW/CoC
- ▶ 미세 피치 인터커넥트
- ▶ 수동소자와 멀티 칩 통합
- ▶ Filter/Lens Holder Ready
- ▶ Optical 테스트 개발
- ▶ 자동차 등급 재료와 조립

Optical Sensor Packages

Open Tool Available (Smiple Builds)	Lead Count	Body Width (mm)	Body Length (mm)	Body Thickness (mm)	Pkg Type	Glass/Lid Type	Die Qty	Interconnect	Factory
	80	11	12	2	Cavity BGA	Glass	Multi-die	WB	P3/K4
	8	9	10	0.6	Film Assist Mold	Glass	Multi-die	WB	C3/K4/JFO
	8	5	2	1	Molded Cavity LGA	Polymer	Multi-die	WB	K4
	22	6.8	4.9	1.35	Cavity LGA	Polymer with Glass/Filter	Multi-die	WB	K4

고객의 요구사항에 따라 사양은 달라질 수 있습니다.

Optical Sensor Package Standards

패키지 유형	Exposed Die Molded	Cavity Package
ChipArray® LGA/FPBGA		

라미네이트와 세라믹 기판 가능

자세한 내용은 amkor.com을 방문하거나 ATKQnA@amkor.co.kr로 이메일을 보내십시오.



본 문서의 모든 콘텐츠는 저작권법에 따라 무단복제 및 배포를 금지하며, 제공된 정보의 정확성을 보장하지는 않습니다. 앰코는 본 문서의 정보사용에 따른 특허나 라이선스 등과 관련된 어떠한 형태의 피해에 대해서도 책임을 지지 않습니다. 본 문서는 앰코의 제품보증과 관련하여 표준판매약관에 명시된 것 이상으로 확대하거나 변경하지 않습니다. 앰코는 사전고지 없이 수시로 제품 및 제품정보를 변경할 수 있습니다. 앰코의 이름 및 로고는 Amkor Technology, Inc.의 등록상표입니다. 그 외 언급된 모든 상표는 각 해당 회사의 자산입니다.
© 2018 Amkor Technology Incorporated. All Rights Reserved. TS113A Rev Date: 11/18

